



FOR IMMEDIATE RELEASE:

Advanced packaging industry: what we could expect in 2017...

Advanced Packaging & System Integration Technology Symposium –
April 20&21, 2017 – Wuxi, China



里昂,法国 –4 月 3 号, 2017 年

2016 年是半导体行业产业整合及蓬勃发展的一年。Yole [Développement](#) (以下简称' Yole')指出, 这一年中, 多宗半导体相关企业的合并/收购金额达到了数十亿美元。

“2017 年也会遵循同样的发展路线,” Jérôme Azemar (Yole 先进封装领域的市场及技术分析师) 在一篇发表在 [i-micronews.com](#) 的文章中表达了这个观点, “根据我们的估算, 先进封装的市场收益在 2016 年已经超过了 220 亿美金, 预计到 2020 年会达到 300 亿美金。”

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 (以下简称 '华进') 和 Yole 将举办为期 2 天的会议--[第三届先进封装及系统集成技术国际研讨会](#)。先进封装的专家为您深度解读行业内的热点、疑点。此次研讨会将于 4 月 20、21 号在中国无锡举办, 赞助商云集了 BESI, Plasma-Therm, SPTS Technologies, UnitySC 和 Simco-Ion。值得一提的是, 香港应科院今年再次作为研讨会的合作主办单位。

此次研讨会邀请到了行业内重量级的嘉宾, 包括:

- Tetsukazu Sugiya, Group Leader, Technology Solutions Group at DISCO Corp.

- Lianming Tong, Lead Marketing Manager at Dow Electronics Materials
- Kenji Kawada, Staff Engineer at Infineon Technologies Japan
- Daquan Yu, CTO & VP, Kunshan Huatian Technology Electronics
- Howard Huang, Director, Kingyop Optronics
- Tae-Hoon Kim, Ex. President, nepes Corporate
- Dr David Lishan, Principal Scientist at Plasma-Therm
- Richard Barnett, Etch Product Manager, SPTS, an Orbotech Company 等

今年的会议将会设计 2 个主题环节，分别来自中芯国际和 Brewer Science..



“很荣幸有机会与 Yole 再次举办国际先进封装和系统集成技术研讨会”

，华进半导体封装先导技术研发中心有限公司总经理曹立强博士讲到，“联合国内外上下游顶尖企业、研究院，以及先进封装领域的专家、学者，对于推动中国产业化进程和形成未来封装体系起着关键的作用。在这种大环境背景下，我们热烈欢迎先进封装的专家参与此次研讨会，展示最新研发成果，积极参与讨论，并且预祝此次会议取得圆满成功”。

，展示最新研发成果，积极参与讨论，并且预祝此次会议取得圆满成功”。

中国先进封装的市场收益份额到 2020 年有望达到 46 亿美金，复合年平均增长率高达 16%。“事实上，我们正在经历着半导体行业蓬勃发展的时代，” Thibault Buisson, (Yole 先进封装&半导体制造的市场经理) 分析，“目前大量的技术挑战从芯片制造转移到了芯片

封装, 这也正是不同商业模式的半导体公司积极参与到先进封装领域的原因。在激烈的竞争大环境下, 先进型封装如扇外型封装、3D&2.5D 封装、系统级封装获得了越来越多的终端用户的青睐, 同时也在逐渐改变着整个封装体系运行。华进&Yole 研讨会将会为您提供一个了解产业链运作机制及未来市场发展趋势的平台。”

如您想获得行业内交流、合作、展示的机会, 请点击:
[Registration.](#)

关于华进- www.ncap-cn.com

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称‘华进’）是一个由中国 10 家半导体封装、检测的龙头企业及微电子所共同投资成立的有限公司。华进公司目标是建设在国际半导体封测领域中具有影响力的国家级封装与系统集成先导技术研发中心, 在部分领域能够引领国际产业技术发展。面向我国集成电路产业结构调整和创新需求, 建设世界一流水平的国际化产业技术研发中心, 在全球创新链中占有自己的位置, 从而推动我国集成电路产业做大做强。

公司作为国家级封测/系统集成先导技术研发中心, 通过以企业为创新主体的产学研用结合新模式, 开展系统级封装/集成先导技术研究, 研发 2.5D/3D TSV 互连及集成关键技术（包括 TSV 制造、凸点制造、TSV 背露、芯片堆叠等）, 为产业界提供系统解决方案。同时开展多种晶圆级高密度封装工艺与 SiP 产品应用的研究, 以及与封装技术相关的材料和设备的验证与研究。

公司拥有 3200 m² 的净化间和 300mm 晶圆整套先进封装研发平台（包括 2.5D/3D IC 后端制程和微组装, 测试分析与可靠性）及先进封装设计仿真平台。

关于 Yole Développement – www.yole.fr

成立于 1998 年的 Yole Développement 已经成长为集团性的公司。具体的业务范围包括: 市场分析报告、技术策略咨询服务及公司金融服务。基于硅基产品及微制造方面有者独特的视野, Yole Développement 已经成长为包含世界上 50 多家合作单位, 横跨 MEMS、化合物半导体、射频电子、LED、显示、图像传感器、光电、Microfluidics & Medical、先进封装、制造、纳米材料、高功率电子、电池&电源管理等多个领域。

作为新“摩尔定律”的研究者, Yole 联合它的合作伙伴 System Plus Consulting、Blumorpho 和 KnowMade, 协助产业链上下游的企业、发明人、和全球各地研发单位、组织, 了解市场需求及企业技术增长点。

- 企业咨询&金融服务: Jean-Christophe Eloy (eloy@yole.fr)
- 报告: David Jourdan (jourdan@yole.fr)
- 新闻稿件&企业信息传播: Sandrine Leroy (leroy@yole.fr)

